

Agenda

Mittwoch, 20. Mai 2026

ANS answer elektronik GmbH | Heegwaldring 25 | 63694 Limeshain

Die Teilnahme ist kostenlos.
Alle Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung
finden Sie auf der Event-
Webseite:
<https://www.seho.de/xtron/>



- 9:30 Uhr Get together: Willkommen bei ANS answer elektronik.
- 10:00 Uhr Begrüßung und Vorstellung des Tagesablaufs.
- 10:15 Uhr **Keynote: Click – Boom – Aus: Produktionsstillstand**
Kevin Palinkas | SPARROW42
- Tauchen Sie in die Welt der Cyber-Erpresser ein. Ein Cyber-Angriff betrifft mehr als nur die IT. Er hat es auf den Produktionsstillstand abgesehen. Werfen Sie einen Blick auf Ihre kritischen Geschäftsprozesse aus der Sicht der Angreifer. Und wie Sie den Angreifern auf Augenhöhe begegnen können.
- 11:00 Uhr **Herausforderungen durch miniaturisierte Bauformen im Reflow-Lötprozess:
Vom empfohlenen Pad-Design zum zuverlässig gelöteten Bauteil**
Helge Schimanski | Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie ISIT
- Dioden der Größe 01005 (0,4 x 0,2 mm) stellen den SMD-Fertigungsprozess vor neue Herausforderungen. Miniaturisierte Bauelementabmessungen und verdeckt liegende Anschlussflächen müssen im Verarbeitungsprozess berücksichtigt werden. Reproduzierbarer Lotpastendruck auf der einen und ein sicherer Lötprozess auf der anderen Seite sind notwendige Voraussetzungen für die Fertigung qualitativ hochwertiger Elektronik. In einer Fertigungsstudie werden verschiedene Aspekte einer „Application Note“ für einen Baugruppenfertigungsprozess beleuchtet. Hierzu wird aus mehreren Varianten das optimale Leiterplattenlayout ermittelt und einschränkende Randbedingungen bei der Leiterplattendimensionierung und Prozessierung thematisiert.
- 11:45 Uhr **Xchange – X-Factory: Live-Demonstration der ANS Total Line.**
- 12:15 Uhr **Xchange (Austausch, Fragerunde, Mittagspause)**
- 13:00 Uhr **EMS-Markt im Wandel: Zahlen, Trends, Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven**
Dr. Mareike Haaß | in4ma
- Der EMS-Markt in Deutschland und Europa befindet sich im Wandel. Wie haben sich die Zahlen im letzten Jahr entwickelt? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Branche, und welche Weichen müssen für die Zukunft gestellt werden? Dieser Vortrag liefert aktuelle Marktdaten, analysiert Trends und gibt einen fundierten Ausblick auf die kommenden Herausforderungen und Chancen

13:45 Uhr **3D PatchWork® Schablone – präzise Antwort auf komplexen Lotpastendruck**
Andreas Axmann | LaserJob GmbH

Die Anforderungen an SMD-Schablonen nehmen stetig zu: Vorbestückte Bauteile auf Leiterplatten, Druck auf unterschiedlichen Ebenen sowie das Bedrucken von Flexleiterplatten stellen neue Herausforderungen dar.
Mit 3D-PatchWork-Schablonen zeigt LaserJob, wie sich diese Aufgaben zuverlässig und prozesssicher meistern lassen.

14:30 Uhr **Xchange (Austausch, Fragerunde, Kaffeepause)**

14:45 Uhr **Gesamtkosten im Reflowprozess reduzieren**
Oliver Wehner | BTU Europe

Der Vortrag zeigt, wie sich die Gesamtkosten im Reflow-Lötprozess durch höhere Anlagenverfügbarkeit, reduzierte Stickstoff- und Energiekosten sowie optimierte Ofenauslastung deutlich senken lassen.
Im Fokus stehen dabei robuste Ofenkonzepte, innovative Prozessgasreinigung, energieeffiziente Betriebsweisen und softwaregestützte Werkzeuge zur schnelleren Rezeptentwicklung, Prozessüberwachung und Minimierung von Produktwechselzeiten.

15:30 Uhr **Xchange (Austausch, Fragerunde, Kaffeepause)**
